

上海展会 2024年日本东京电子元器件及制造技术展 NEPCON JAPAN

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 上海展会 2024年日本东京电子元器件及制造技术展 NEPCON JAPAN |
| 公司名称 | 星美（深圳）国际展览有限公司 |
| 价格 | 45800.00/件 |
| 规格参数 | 物流运输:展品送至贵司展位 展团服务:机票酒店餐饮大巴车一站式服务 展后补贴:一直跟进到补贴款到账 |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区龙岗大道(龙岗段)4003号B座702-11A（注册地址） |
| 联系电话 | 13682182855 13682182855 |

产品详情

市场介绍日本是一个高度发达的资本主义国家。其资源匮乏并极端依赖进口，发达的制造业是国民经济的主要支柱。科研、航天、制造业、教育水平均居shijieqian列。

此外，以动漫、游戏产业为首的文化产业和发达的旅游业也是其重要象征。据调查，日本在环境保护、资源利用等许多方面堪称世界dianfan，其国民普遍拥有良好的教育、极高的生活水平和国民素质。

日本是电子工业强国，随着近年来人工智能电子工业的不断发展，日本本土的电子制造业呈现出衰退的趋势，由过去的销售快速增长到现在的依赖于电子核心部件、上游化学材料保有优势。

在返个过程中，日本市场呈现出新的需求，为中国的整机产品、配套产品制造企业打入日本市场带来了良好的契机，同时也带来了广阔的合作机遇。

据日本海关统计，2019年1月，日本与中国双边货物进出口额为764.0亿美元。其中，日本对中国出口340.5亿美元，总额增长14.2%；自中国进口423.5总额增长7.0%。日本与中国的贸易逆差83亿美元。中国是日本第二大出口目的地。

展会介绍：

日本国际电子元器件、材料及生产设备展览会从1972年举办至今，在2000年，日本国际电子元器件、材料及生产设备展览会增设了IC封装技术、印制电路板以及电子元件的展览部分，进一步提高了展会的价值，使之成为“电子研发、设计以及制造等领域的国际性综合展览会”，近年，在此规模基础上又新增了关于汽车电子、电动汽车、LED/OLED照明技术以及可穿戴式电子产品等拥有良好发展前景的同期展会，这一展会随着日本电子行业的发展也在不断的成长壮大自己。最近几年，来自中国、韩国、台湾的参展商以及观展人士不断增加。日本本就是电子行业的强国，如今它还在扩大自己。

日本东京电子元器件及设备展NEPCON

JAPAN是亚洲大型的电子设计、研发与制造技术展览会。日本东京电子元器件及设备展NEPCON JAPAN自1972年举办至今，随着日本电子行业的发展也在不断的成长壮大。每年展会上都会展示众多电子制造业的**成果。

涉及领域包括SMT、IC封装、PCB/PWB、测量/分析、电子元件/材料、精密加工。在2000年，日本东京电子元器件及设备展增设了IC封装技术、印制电路板以及电子元件的展览部分，进一步提高了展会的**，使之成为“电子研发、设计以及制造等领域的**性综合展览会”。日本东京电子元器件及设备展NEPCON JAPAN作为了解“未来电子产业”较新技术的**场所而备受业界瞩目。

展览范围

- 1、电子产品制造设备及部件技术展 INTERNEPCON JAPAN：贴片机、点胶机、焊接设备/材料、封装设备、清洗设备、激光加工机、EMS/电子代工服务、清洁/静电防护器材、工厂/厂房设备
- 2、电子零部件检测设备及开发技术展ELECTROTEST JAPAN：各种检测设备、X射线检测设备、测试仪器、分离设备/软件、可靠性/评估检验设备、CCD相机、无损检测设备、合同分析服务
- 3、电子零部件封装设备及开发技术展 IC & Sensor Packaging TechnologyEXPO：装配设备、包装材料/组件、IC封装分析/模拟软件、SATS/契约设计服务、电镀/蚀刻材料及设备、MEMS设备/封装设备
- 4、电子元件及材料展ELECTRONIC COMPONENTS & MATERIALSEXPO：接线器、线缆、传感器、接线端子、电源开关、电阻器、转换器、电路安装材料、纳米技术材料
- 5、印刷电路展PWB EXPO – Printed Wiring Boards Expo：装配设备、保证材料/组件、IC封装分析/模拟软件、半导体器件/检测设备、SATS/契约设计服务、电镀/蚀刻材料及设备、MEMS设备/封装设备
- 6、精密加工技术展 FINE PROCESS TECHNOLOGY EXPO:冲压加工、切削/钻孔、精密/微细钣金加工、金属成型、电铸、精密铸造、镜面磨削、镭射加工、模塑、难切削材料加工